



半导体产品与半导体设备行业跟踪报告：半导体设备材料国产化紧迫



美国对中国半导体企业的技术封锁再次加码，国产替代主线明确。2022 年 10 月 7 日，美国 BIS 宣布了对美国《出口管理条例》(EAR) 的一系列修订，并公布针对中国企业的新的出口管制限制措施，细则瞄准中国高端芯片产业，严格限制中国企业获取发展高性能计算芯片、超级计算机以及特定半导体制造能力所需的设备、零部件、技术能力等。本次 BIS 新规主要制约中国晶圆制造先进制程的发展，对成熟制程的限制程度较低。从事先进制程芯片设计、制造等业务的企业，在研发端、采购端、销售端均可能面临严格限制，后续业务的发展甚至生存都将面临严峻挑战。

大基金二期投资重点短板领域，国内扶持半导体产业链实现自主可控的决心强大。2019 年 10 月，国家大基金二期成立，相比大基金一期，大基金二期投资领域更为集中。二期除了对产业链各领域的龙头企业继续保持高度关注和持续支持外，更加聚焦短板明显的设备、材料领域，方向集中于完善半导体产业链。

在国内不断扶持下，半导体产业链国产替代将加速进行，而设备材料及零部件作为晶圆制造上游环节将首先受益。根据国际电子商情微信公众号援引 ICInsights, 继 2021 年全球半导体资本开支激增 35% 后, 预计 2022 年行业资本开支将达 1817 亿美元历史新高, 但增速呈现放缓态势, 预计 23 年同比下降 19% 至 1466 亿美元。国内方面, 由于美对华实行半导体制裁, 阻碍国内先进制程的发展, 部分客户先进制程扩产放缓, 短期来看设备厂商业绩或将承压, 但成熟制程仍然继续加大国产替代。

投资建议。美国多轮半导体制裁政策下，半导体设备材料国产替代确定性不断深化，作为晶圆制造核心，半导体设备及零部件板块投资机会显现，优质半导体设备零部件龙头企业包括北方华创、拓荆科技、盛美上海、中微公司、长川科技、富创精密；同时，半导体材料作为制造后周期赛道，用量将伴随 2021-2022 年资本开支投放不断上升，建议关注标的包括鼎龙股份、安集科技、沪硅产业、德邦科技等；此外，晶圆制造端，国内代工厂也将在国家大基金扶持下不断拓展先进制程工艺，实现技术纵向拓展，建议关注中芯国际。

风险提示。终端需求回暖不及预期，半导体国产替代进程不及预期。

关键词: AR 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51990

